

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

②① Anmeldenummer: 78101690.2

⑤① Int. Cl. 2: **C 23 C 13/00, C 03 C 17/08**

②② Anmeldetag: 15.12.78

③① Priorität: 21.12.77 US 862797

⑦① Anmelder: **International Business Machines Corporation, Armonk, N.Y. 10504 (US)**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: 11.07.79
Patentblatt 79/14

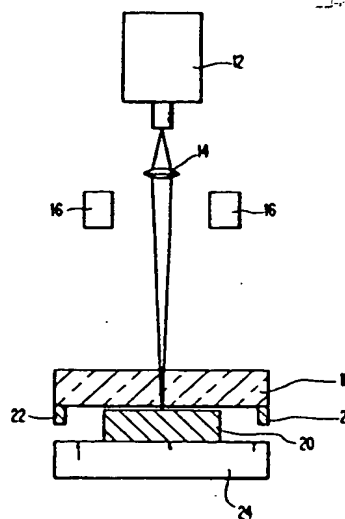
⑦② Erfinder: **Drew, Roland Francis, 22 Lori Street, Poughkeepsie, N.Y. 12603 (US)**
Erfinder: **Schmidt, Frank John, Jr., Cragston, Highland Falls, N.Y. 10928 (US)**
Erfinder: **Vanduyndhoven, Thomas Jerome, 27 Russett Road, Poughkeepsie, N.Y. 12601 (US)**

⑥④ Benannte Vertragsstaaten: **DE FR GB**

⑦④ Vertreter: **Willich, Wolfgang, Dipl.-Ing., Schönaicher Strasse 220, D-7030 Böblingen (DE)**

⑤④ Verfahren zum Aufbringen einer Materialschicht auf eine Fläche eines plattenförmigen Werkstücks mittels eines Laserstrahls.

⑤⑦ Verfahren zum Auftragen einer Materialschicht auf eine Fläche eines plattenförmigen Werkstücks mittels eines Laserstrahls. Das Werkstück (18) besteht aus transparentem Werkstoff, das aufzubringende Material (20) ist in einer Ebene in unmittelbarer Nähe zu der zu beschichtenden Werkstückfläche angeordnet, und der Laserstrahl wird von der entgegengesetzten Werkstücksseite auf das Werkstück gerichtet. Dadurch wird das Material (20) an der jeweiligen Auftreffstelle des Laserstrahls verdampft und schlägt sich an den entsprechenden Positionen der Werkstückfläche nieder.



EP 0 002 738 A1

Verfahren zum Aufbringen einer Materialschicht auf eine
Fläche eines plattenförmigen Werkstücks mittels eines
Laserstrahls

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen einer
Materialschicht, vorzugsweise in bestimmten Mustern, auf
eine Fläche eines plattenförmigen Werkstücks durch Ver-
dampfen des in einer Ebene nahe der Werkstückfläche befind-
5 lichen Materials mittels eines Laserstrahls, und zwar
speziell für Werkstücke aus transparentem oder teiltrans-
parentem, also in einem bestimmten Maße lichtdurchlässigem
Werkstoff.

- 10 Laserstrahlen werden als Energiequelle für die unterschied-
lichsten Zwecke eingesetzt, z. B. zur Erzeugung von Impulsen
einer amplitudenmodulierten kohärenten Strahlung zur Bildung
von Löchern in metallischem Werkstoff, etwa zum Zwecke der
Herstellung von Faksimile-Abbildungen hoher Auflösung
15 (US-PS 4 000 492). Eine andere Einsatzmöglichkeit ist die
Aufzeichnung und Wiedergabe von flächigen Mustern und Dar-
stellungen mittels eines Digital-Lasers, wie in der
US-PS 4 001 840 beschrieben.

- 20 Die Energie eines Laserstrahls läßt sich aber auch zum Ab-
scheiden von Schichten auf Werkstücke einsetzen; so ist im
IBM Technical Disclosure Bulletin, Band 8, Nr. 2, Seite 285,
(Juli 1965) eine Anordnung gezeigt, bei der ein Laserstrahl

in eine Vakuumkammer gerichtet wird, in welcher in einem gewissen Abstand vor dem zu beschichtenden Werkstück, einem Trägerkörper für eine elektronische Schaltungseinheit, eine dünne Schicht des Beschichtungsmaterial parallel zu der zu
5 beschichtenden Fläche, z. B. auf der Rückseite einer Glasplatte, angeordnet ist. Unter der Wirkung des Laserstrahls verdampft das Material und schlägt sich im Vakuum auf die Werkstückoberfläche nieder.

- 10 Bei einer ganz ähnlichen Laserstrahlanordnung gemäß der US-PS 3 560 258 befindet sich das Beschichtungsmaterial gleichfalls vor dem Werkstück in einer evakuierten Kammer, und zwar ist es dort als dünne Schicht auf der Oberfläche einer Glasplatte aufgetragen und in sehr geringem Abstand
15 von der Werkstückfläche angeordnet. Der Laserstrahl tritt somit durch die Glasplatte hindurch und verdampft an denjenigen Stellen, auf welche der Strahl gerichtet wird, das Beschichtungsmaterial zur Bildung eines entsprechenden Musters auf dem Werkstück.

20

- Die bekannten Anordnungen von Verfahren zur Bildung einer Schicht, ggf. in Form eines vorgegebenen Musters, haben verschiedene Nachteile. So ist mit der Anordnung nach der US-PS 3 560 258 eine aufwendige Überwachung der Schichtdicke
25 auf der Basisplatte erforderlich, um die gewünschte Schichtstärke auf dem Substrat zu erzielen. Außerdem ist das dort beschriebene Verfahren teuer; denn die Basisplatte mit dem Materialfilm kann nur einmal verwendet und muß für einen weiteren Beschichtungsvorgang erneuert werden. Schließlich
30 ist auch die Überwachung der Ausrichtung des Musters auf dem Substrat erschwert, weil der auf der Glasplatte befindliche Materialfilm die Sicht auf das Werkstück verdeckt und somit die Beobachtung der Laserstrahlausrichtung verhindert.

- 35 Mit dem Verfahren nach der Erfindung wird die Aufgabe gelöst, die Oberfläche eines Werkstücks aus transparentem oder
FI 977 044

zumindest durchscheinendem Werkstoff auf eine kostengünstige und zuverlässige Weise mittels eines Laserstrahls mit einem Material zu beschichten, insbesondere zum Zwecke des Auftragens eines vorgegebenen, durch die Bewegungen des Laserstrahls bestimmten Musters. Das erfindungsgemäße Verfahren ist im Patentanspruch 1 angegeben.

Bei dem aufzutragenden Material handelt es sich vorzugsweise um ein Metall, jedoch eignet sich das Verfahren
10 grundsätzlich auch zur Anwendung beim Auftragen anderer Materialien, welche mittels des Laserstrahls verdampft werden können. Eine bevorzugte Anwendung ist die Bildung von Leiterzügen auf Festkörper-Schaltungssubstraten, zur Bildung von Mustern aus Leitern und Widerständen. Das
15 erfindungsgemäße Verfahren kann aber auch zur Bildung und zur Instandsetzung von metallischen Masken auf Glasplatten eingesetzt werden. Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist auch, daß es die Möglichkeit bietet, das Beschichtungsmaterial in Form eines Materialblocks oder
20 in einem Schmelztiegel bereitzustellen, so daß eine Vielzahl von Beschichtungen aufeinanderfolgend durchgeführt werden kann.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird nachfolgend im einzelnen
25 erläutert. Hierzu ist in der Zeichnung eine Laserstrahlanordnung zur Beschichtung eines Werkstückes aus transparentem Werkstoff schematisch dargestellt.

Die in der Zeichnung dargestellte Laserstrahlanordnung
30 besteht aus einer Laserstrahlquelle 12, einer Linse 14 und einem Ablensystem 16. Zur Beschichtung eines transparenten Werkstücks 18, z. B. eines Substrats, auf der an der Unterseite befindlichen Fläche mit einem vorgegebenen Material ist unmittelbar benachbart zu dieser Fläche ein entsprechender
35 Materialblock 20 angeordnet. Für die Laseranordnung kann beispielsweise ein Festkörperlaser der Bauart Nd^{3+} YAG mit

einer Wellenlänge in der Größenordnung von $1,06 \mu$ vorgesehen werden. Die Wellenlänge des Lasers ist jedoch auf die Transparenz-Wellenlänge des Werkstücks 18 abzustimmen.

- 5 Das Werkstück 18 ist an seinen Kanten auf einem Rahmen 22 gelagert, und der Metallblock 20 liegt auf einer Trägerplatte 24 auf. Der Abstand zwischen der Fläche an der Unterseite des Werkstücks 18 und der Fläche an der Oberseite des Materialblocks 20 ist sehr gering, nämlich in der Größenordnung von 50 bis 100μ . Grundsätzlich ist es auch möglich, das Werkstück 18 unmittelbar auf dem Materialblock 20 zu lagern. Für das Ergebnis des mit der dargestellten Anordnung durchzuführenden Beschichtungsverfahrens hat der Abstand zwischen dem Werkstück 18 und dem Materialblock 20 eine maßgebliche Bedeutung; man kann daher die Anordnung auch so gestalten, daß der betreffende Abstand auf unterschiedliche Werte einstellbar ist.

Der Materialblock 20 besteht entweder ausschließlich aus dem für die Beschichtung vorgesehenen Material, oder er ist als Behälter gestaltet, der mit dem gewünschten Material gefüllt ist. Zur Beschichtung mittels Laserstrahl haben sich Kupfer, Messing, Chrom und Aluminium als besonders geeignet erwiesen. Das Werkstück 18 ist, wie bereits erwähnt, aus transparentem Werkstoff, welcher sich für die Beschichtung mit Metall eignet. Es kann beispielsweise als Glasplatte ausgebildet sein. Für die Beschichtung des Werkstücks 18 kommen aber auch nicht leitende Materialien in Frage, die entweder als geschlossene Schicht oder in Form eines vorbestimmten Musters aufgetragen werden. Besondere Bedeutung für die Auswahl des Werkstoffs des Werkstücks 18 in Anpassung an die Frequenz des Laserstrahls hat auch die Lichtablenkcharakteristik des für das Werkstück 18 vorgesehen transparenten Werkstoffs.

- 35 In der praktischen Anwendung der dargestellten Anordnung wird auf der unteren Fläche des Werkstücks 18 entsprechend den

Vorschubbewegungen des Laserstrahls ein bestimmtes Muster aufgetragen, vorzugsweise aus leitendem Material, wobei die Vorschubbewegungen des Laserstrahls durch das Ablenk-
system 16 bestimmt werden. Entsprechend den durch das Ablenk-
5 system 16 erzeugten Bewegungen des Laserstrahls wird an den jeweils vom Strahl getroffenen Positionen des Metallblocks 20 das Material verdampft und auf der zugeordneten Fläche des Werkstücks 18 niedergeschlagen. Hierbei ist eine einheitliche Schichtdicke des Niederschlags erzielbar, und bei entsprechen-
10 der Auswahl der Materialien des Blocks 20 und des Werkstücks 18 findet eine zuverlässige Adhäsion zwischen Schicht und Trägerfläche statt. Entsprechendes gilt für die Beschichtung mit nichtmetallischen Materialien, z. B. einem keramischen Werkstoff, soweit sich das betreffende Material für die Ver-
15 dampfung durch den Laserstrahl eignet.

Verwendet man für den Materialblock anstelle eines Blocks einen mit dem betreffenden Material gefüllten Behälter, z. B. einen Schmelztiegel, und erhitzt man das Material auf
20 eine Temperatur knapp über dem Schmelzpunkt, so werden Veränderungen, wie Vertiefungen oder Niederschläge, auf der Behälterwand vermieden und der Schmelztiegel kann für einen fortlaufenden Beschichtungsprozeß verwendet werden.

25 Als Beispiel sei angenommen, mit der in der Zeichnung dargestellten Anordnung soll mittels eines YAG-Lasers mit einer Wellenlänge von $1,06 \mu$ auf das als Glasplatte ausgebildete Werkstück eine Kupferschicht aufgetragen werden. Der Materialblock 20 für das Kupfer habe eine Größe von $6 \times 6 \text{ mm}$
30 und die Glasplatte eine Kantenlänge von $1,5 \text{ mm}$. Die Impuls-Repetitionsrate des Lasers betrage 3 kHz bei einer durchschnittlichen Leistung von 2 Watt , und die Vorschubgeschwindigkeit des Lasers sei mit 2 mm/s angenommen. Die erzielbare Breite der auf der Werkstückfläche niedergeschlagenen Leiter-
35 züge beträgt sodann 250μ und weniger bei einheitlicher Dicke der Schicht und guter Adhäsion zwischen Werkstückoberfläche und Kupferschicht.

- 1 -

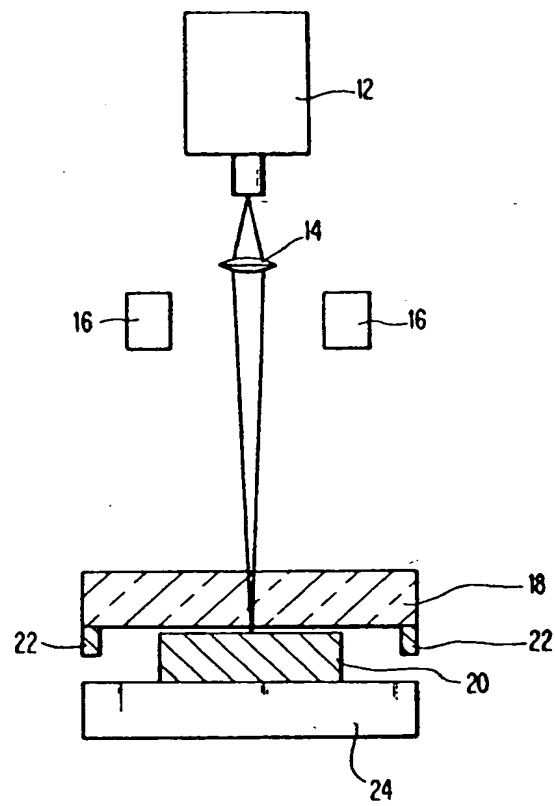
P A T E N T A N S P R Ü C H E

1. Verfahren zum Auftragen einer Materialschicht, vorzugs-
weise in bestimmten Mustern, auf eine Fläche eines
5 plattenförmigen Werkstücks, durch Verdampfen des in
einer Ebene nahe der Werkstückfläche befindlichen
Materials mittels eines Laserstrahls,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Werkstück aus transparentem Werkstoff besteht
10 und daß der entsprechend dem vorgesehenen Muster bewegte
Laserstrahl von der entgegengesetzten Werkstücksseite
auf das Werkstück gerichtet wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
15 dadurch gekennzeichnet,
daß das Material leitend ist.
3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
20 daß als Material Kupfer verwendet wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Werkstück aus Glas besteht.

5. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Laserstrahl mit einer Vorschubgeschwindigkeit
von etwa 2 mm/s bewegt wird.
- 5
6. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Laserstrahl von 2 Watt Leistung verwendet wird.
- 10 7. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Laserstrahl mit einer Impuls-Repetitionsrate
von etwa 3 kHz betrieben wird.

0002738

1/1





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0002738
Nummer der Anmeldung

EP 78 10 1690

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	<u>DE - A - 1 621 306</u> (PHILIPS) * Patentanspruch 1 *	1	C 23 C 13/00 C 03 C 17/08
AD	<u>US - A - 3 560 258</u> (A.D. BRISBANE) * Patentanspruch 1 *	1	
A	<u>DE - A - 1 521 323</u> (IBM) * Patentanspruch 1 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.)
			C 23 C 13/00 C 03 C 17/08 B 23 K 26/00 H 05 K 3/10
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
Den Haag	13-03-1979	VAN DEN BULCKE	